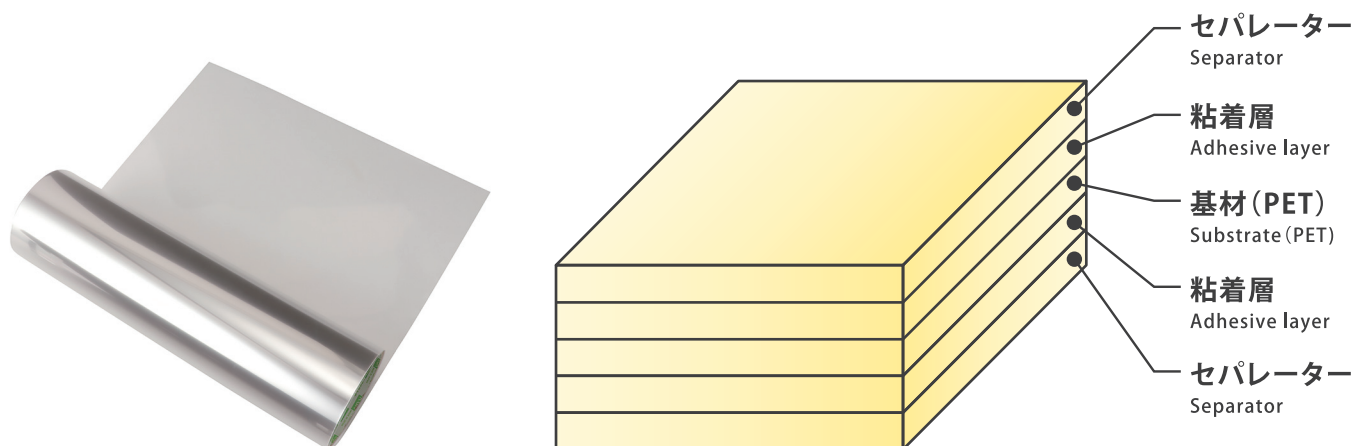
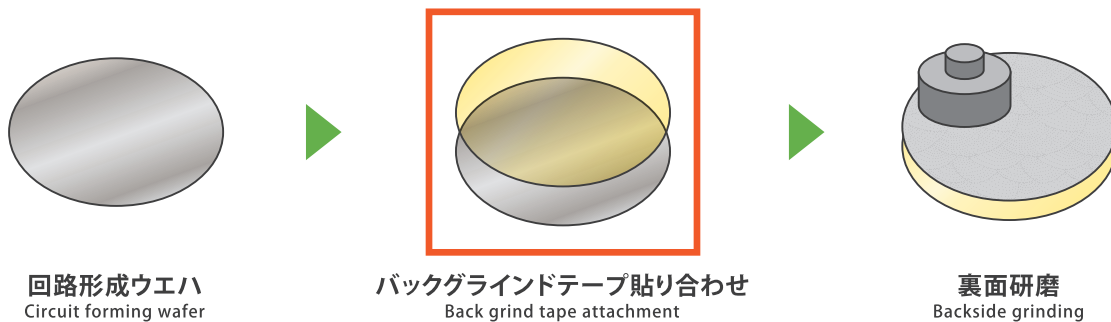




ウエハの裏面研削 (バックグラインド) 時に回路面を外的異物による傷、チッピング (欠損)、クラック (割れ) やコンタミネーション (汚染) などからの保護用途です。

It is used to protect the circuit surface from scratches, chipping, cracks, and contamination caused by external foreign objects during back grinding of the wafer.



品番 Part number	基材 Substrate	厚み Thickness (mm)	粘着力 SUS 強粘着面 Adhesive strength: SUS Strong adhesive surface (N/25mm)	粘着力 SUS 微粘着面 Adhesive strength: SUS Weakly adhesive surface (N/25mm)	用途 Application
214D	ポリエステル polyester	0.115	25	15	半導体ウエハの 研磨洗浄工程 Semiconductor wafer polishing and cleaning process

特徴: 上記の性能に限らず各種項目をカスタマイズ対応可

Features: Not only the above performance but also various items can be customized

基材 Substrate	粘着剤 Adhesive	粘着力 Adhesive strength (N/25mm)	厚み Thickness	構成 Configuration	密着方式 Adhesion method	UV硬化 UV curing	色 color	用途 Application	その他 カスタマイズ Other customizations
PVC PVC ポリエステル polyester PET PET PO PO	アクリル系 Acrylic ウレタン系 Urethane エポキシ系 epoxy シリコン系 silicon ゴム系 rubber	調整可能 adjustable	50 μ m ~ 1000 μ m	1~3層 1~3 layer	感圧タイプ Pressure-sensitive type	調整可能 adjustable	調整可能 adjustable	バックグラインド Background Grind ダイシング Dicing	UV硬化あり・なし With or without UV curing 帯電防止付与 Anti-static imparting 機械強度 Mechanical Strength